

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2019-019

## **江苏长电科技股份有限公司**

### **2019 年度为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

1、被担保人名称：长电科技（宿迁）有限公司、长电科技（滁州）有限公司、江阴长电先进封装有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPAC KOREA LIMITED、星科金朋半导体（江阴）有限公司、JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.、STATS CHIPAC PTE. LTD.。

2、对外担保累计金额：截止 2018 年 12 月 31 日，本公司为全资子公司融资及其他业务累计担保余额为 43.04 亿元人民币，无对外担保。

3、反担保情况：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

#### **一、担保情况概述**

为满足全资子公司 2019 年度经营发展需要，并考虑到集团内部借款主体调整等因素，公司拟提供总额度不超过 119 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵质押担保、融资租赁担保、经营性租赁担保等；子公司被担保业务方式包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、应付帐款保函、海关税费保函、应收帐款保理、国内证开证及议付、国际证开证及押汇等，具体额度如下：

1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过 5 亿元人民币；

2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过 3 亿元人民币；

3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过 20 亿元人民币；

- 4、对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过 15 亿元人民币；
- 5、对 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（长电韩国）担保不超过 5 亿元人民币；
- 6、对星科金朋半导体（江阴）有限公司（JSCC）担保不超过 15 亿元人民币；
- 7、对 JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.（JCET-SC）及 STATS CHIPPAC PTE. LTD.（SCL）担保合计不超过 56 亿元人民币。

2019 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于本公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

## 二、担保对象简介

### 1、长电科技（宿迁）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本 25,000 万元人民币，主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2018 年末总资产为 109,998.24 万元人民币；净资产为 14,251.26 万元人民币；2018 年营业收入 93,610.14 万元人民币；净利润 5,418.61 万元人民币。（以上数据未经审计）

### 2、长电科技（滁州）有限公司

为本公司全资子公司，注册资本 30,000 万元人民币，主营研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2018 年末总资产为 180,807.43 万元人民币；净资产为 49,930.99 万元人民币；2018 年营业收入 159,515.47 万元人民币；净利润 24,138.38 万元人民币。（以上数据未经审计）

### 3、江阴长电先进封装有限公司

为本公司全资子公司，母公司持股 96.488%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股 3.512%的中外合资企业，注册资本 5,100 万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2018 年末总资产为 360,152.49 万元人民币；净资产为 154,121.16 万元人民币；2018 年营业收入 245,403.79 万元人民币；净利润 23,385.47 万元人民币。（以

上数据未经审计)

4、长电国际（香港）贸易投资有限公司（下称“长电国际”）

为本公司在香港设立的全资子公司，注册资本 24,800 万美元，主营进出口贸易。

2018 年末总资产 259,486.91 万元人民币；净资产为 166,511.10 万元人民币。

（以上数据未经审计）

5、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED

为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶 SiP 产品封装测试。

2018 年末总资产为 46,444.29 万美元，净资产为 22,277.60 万美元。（以上数据未经审计）

6、STATS CHIPPAC PTE. LTD.

为本公司间接持股 100% 的子公司，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商，全球集成电路封测外包公司。

2018 年末总资产为 212,295.64 万美元，净资产为 50,496.54 万美元；2018 年营业收入 116,856.04 万美元，净利润-27,145.21 万美元。（以上数据未经审计）

7、星科金朋半导体（江阴）有限公司

为本公司间接全资子公司，注册资本 32,500 万美元，主营集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装与测试，并提供相关的技术服务。

8、JCET-SC (SINGAPORE) PTE. LTD.

为本公司间接全资子公司，注册资本 1,280,618,888.56 美元，为投资公司。

### 三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2019 年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。

#### **四、董事会意见**

本公司现有担保均为向下属全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

#### **五、对外担保累计金额及逾期担保的数量**

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司为全资及控股子公司累计担保余额为 43.04 亿元人民币，无对外担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一九年四月二十六日